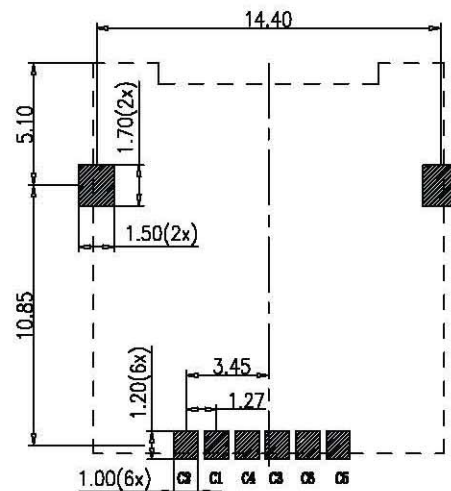
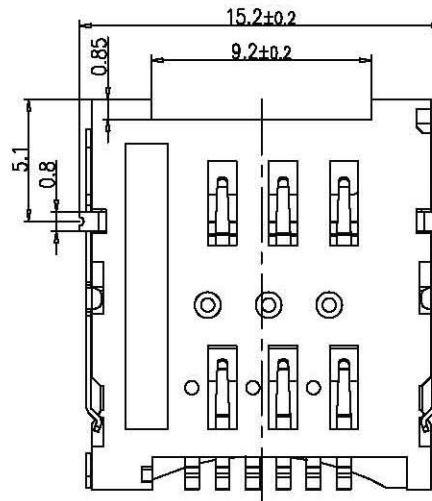
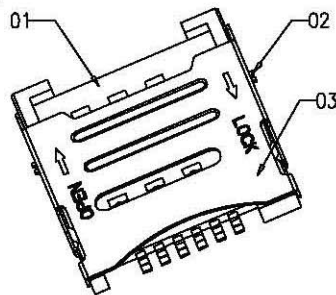
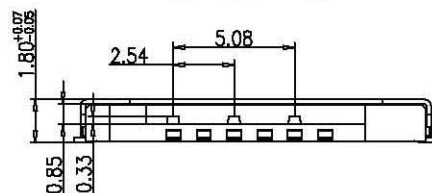
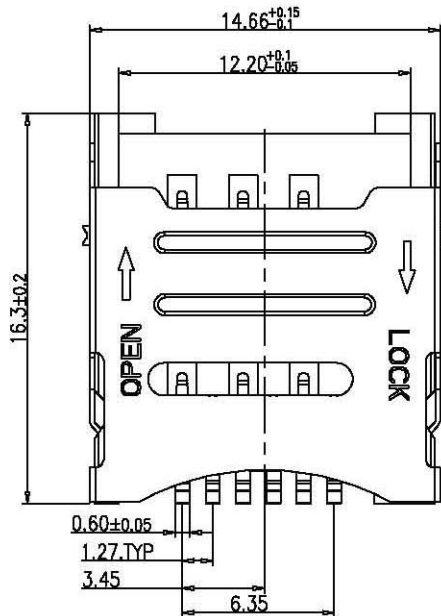
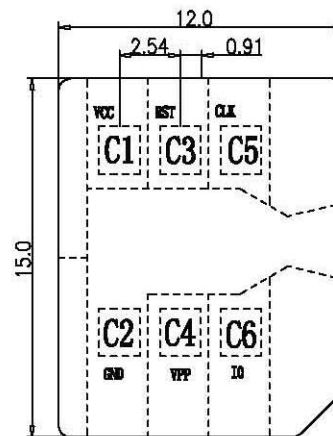




PCB LAYOUT



MICRO SIM

一、材质和镀涂:

- 1、胶芯: LCP, UL 94 V - 0, 黑色
- 2、端子: 磷铜C5210-II, T=0.15, 镍底镀金
- 3、外壳: 不锈钢 SUS304 T=0.2

二、技术参数:

接触电阻: 100mΩ Max
绝缘阻抗: 1000MΩ Min(500DC)
额定电流: 每个接触件1A Max
额定电压: 30V Max(DC)
耐 压: 500V r.m.s/min
使用温度: -40℃~85℃
湿 度: 90%~95%
寿 命: >3000次

PIN NO.	NAME	PIN NO.	NAME
C1	VCC	C4	VPP
C2	GND	C5	CLK
C3	BST	C6	IO

序号	名称	料号	用量
01	端子密封体	M-6101-03-007	1 PCS
		C-6101-03-016	1 SBT
02	定位片	C-6101-03-015	2 PCS
03	外壳	S-6101-01-013	1 PCS

					产品名称 TITLE	Mini 接触SIM 卡座 (H 1.8)
					产品料号 PART NO.	CS-0005-06180
					图 号 DRWG NO.	CS-0005-06180
A	版次 REV	变更单号 EDN NO	变更描述 DESCRIPTION	确认 APPROVA	日期 REV	

东莞市涪程电子科技有限公司

$x \pm 0.2$ $x.x \pm 0.15$ $x.xx \pm 0.08$ $x.xxx \pm 0.02$	$x' \pm 2$ $x.x' \pm 1$ $x.xx' \pm 0.5$	第三角投影法 THIRD ANGLE REFLECTION METHOD	比例: 1:1 SCALE	单位: mm UNIT	版次 REV	A
出图日期 PLOT DATE	批准 APPROVED BY	审核 CHECKED BY	设计 DESIGNER BY	制图 DRAWN BY	页次 SHEET	10F1
2010 08.20	Nicolas	Ryan	Steven	Bill		